



平成 25 年 9 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社テラプローブ
 代 表 者 代表取締役社長 渡辺 雄一郎
 (コード番号：6627 東証マザーズ)
 問合せ先 執行役員 CFO 神戸 一仁
 (TEL 045-476-5711)

組織変更及び人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 9 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 25 年 10 月 1 日付の組織変更並びに人事異動を決定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 組織変更及びその理由

当社は、平成 25 年 10 月 1 日付で当社子会社である株式会社テラミクロスを吸収合併することに伴い、「WLP ビジネスユニット」を「アドバンスド CSP & BUMP ビジネスユニット」に名称変更し、同ビジネスユニットに「アドバンスドパッケージ開発部門」、「プロダクション部門」及び「プロダクションサポート部門」を新設いたします。また、「WLP 品質保証部門」を「ACB(アドバンスド CSP & BUMP)品質保証部門」と名称変更いたします。これらの名称変更は、従来の Wafer Level Package (WLP)に加え、Flip Chip 製品への BUMP 形成などの中間加工も行っていることを明確にする目的で行うものであります。

2. 人事異動

氏名	新役職	旧役職
岡田 修	執行役員 アドバンスド CSP & BUMP ビジネスユニット長	執行役員 WLP ビジネスユニット長 兼株式会社テラミクロス 取締役
横山 均	アドバンスド CSP & BUMP ビジネスユニット エグゼクティブチーフエンジニア	株式会社テラミクロス 取締役
船谷 肇	ファイナンス&アカウンティングオフィス バイスプレジデント兼ファイナンス部門長	株式会社テラミクロス 取締役
大山文雄	CSO(Chief Sales Officer)代理 兼グローバルセールス部門長	CSO(Chief Sales Officer)代理 兼グローバルセールス部門長 兼株式会社テラミクロス 取締役
金子紀彦	アドバンスド CSP & BUMP ビジネスユニット アドバンスドパッケージ開発部門長	株式会社テラミクロス 開発部門長
塚原圭二	アドバンスド CSP & BUMP ビジネスユニット プロダクション部門長	株式会社テラミクロス 製造部門長
児谷昭一	アドバンスド CSP & BUMP ビジネスユニット プロダクションサポート部門長	株式会社テラミクロス 生産管理部門長

※用語解説

CSP (Chip Size Package)	半導体チップのサイズでパッケージされた超小型パッケージの総称
BUMP	半導体を基板に接続するための電極部分の突起
Wafer Level Package	ウェハ状態でパッケージ最終工程まで処理して完成する半導体パッケージ
Flip Chip	半導体チップの電極に BUMP を形成して基板に実装する方法

以 上